

## <<现代微电子技术>>

### 图书基本信息

书名：<<现代微电子技术>>

13位ISBN编号：9787502535926

10位ISBN编号：7502535926

出版时间：2002-1-1

出版时间：化学工业出版社

作者：钱鹤,刘明,吴德馨,叶甜春

页数：236

字数：206000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<现代微电子技术>>

### 内容概要

本书是“高新技术科普丛书”之一。

微电子技术是高技术和信息产业的核心技术，其发展水平和产业规模是衡量一个国家经济实力的标志之一。

全书共分8章，分别介绍了集成电路设计、微细加工技术、CMOS器件及电路制造技术、化合物半导体器件和电路、双极和BiCMOS器件和电路，新型封装技术和测试技术。

本书适合从事高技术和信息产业的研究人员、技术人员、生产人员、管理人员阅读，也可供院校师生参考。

## &lt;&lt;现代微电子技术&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 绪论 1.1 微电子技术发展历程 1.2 微电子技术取得的成就 1.3 微电子技术面临的挑战 参考文献第2章 基于IP的集成电路设计 2.1 系统芯片(SOC)设计 2.2 SOC系统芯片与芯片的设计再利用 2.3 IP知识产权模块 2.4 基于IP的SOC芯片设计 2.5 SOC设计展望 参考文献第3章 微细加工技术 3.1 微细加工技术简介 3.2 光学曝光技术 3.3 X射线光刻技术 3.4 电子束曝光技术 3.5 极紫外光刻技术 参考文献第4章 深亚微米CMOS器件及电路制造技术 4.1 概述 4.2 现代深亚微米CMOS器件 4.3 集成电路工艺技术 4.4 集成电路工艺模块 4.5 CMOS集成电路工艺集成 参考文献第5章 化合物半导体器件和电路 5.1 化合物半导体料简介 5.2 GaAs器件及集成电路 5.3 InP基器件及集成电路 5.4 锗硅器件及集成电路 5.5 化合物半导体器件的发展趋势第6章 双极和BiCMOS器件以及电路 6.1 双极集成电路中的基本元件 6.2 以极集成电路的工艺实现 6.3 先进的双极工艺 6.4 性能卓越的BiCMOS电路 6.5 BiCMOS器件和电路制造技术 6.6 先进的BiCMOS技术及其在数模混合电路和系统集成中的应用 参考文献第7章 新型封装技术 7.1 概述 7.2 传统封装工艺过程 7.3 新型封装技术 7.4 跨世纪的电路装联技术 7.5 下一代微型器件组装技术——电场贴装 参考文献第8章 超大规模集成电路测试技术 8.1 简介 8.2 数字电路测试 8.3 模拟电路及数模混合电路测试 8.4 测试技术展望 8.5 世界主要测试设备公司及产品简介 参考文献

<<现代微电子技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>